

## 深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系活动记录表

证券简称：联得装备

证券代码：300545

编号：2024-012

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 券商策略会
参与单位名称及人员 姓名	第一场：博时基金、宝盈基金、融通基金共 4 人 第二场：华夏基金、长江证券共 2 人 第三场：鹏华基金、长江证券共 2 人
时间	2024 年 9 月 6 日
地点	券商策略会现场（深圳）
上市公司接待人员 姓名	董事、董事会秘书：刘雨晴女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、介绍公司概况</p> <p>简要介绍公司及子公司发展历程、主营业务、近年主要经营业绩，公司及子公司的核心优势及未来发展规划等情况。</p> <p>二、投资者会议问答交流</p> <p><b>Q1：公司主要产品包括哪些设备？</b></p> <p><b>A1：</b>公司主要从事新型半导体显示智能装备、汽车智能座舱系统装备、半导体封测设备、新能源设备的研发、生产、销售及服务。公司主要产品包括绑定设备、贴合设备、偏贴设备、覆膜设备、检测设备、大尺寸/超大尺寸 TV 整线设备、移动终端自动化设备、汽车智能座舱系统组装设备、Mini/Micro LED 芯片分选设备、扩晶设备、真空贴膜设备、巨量转移设备、高精度拼接设备、半导体倒装设备、固晶设备、AOI 检测设备、引线框架贴膜设备、锂电池模切叠片设备、电芯装配段及 pack 段整线自动化设备。</p> <p><b>Q2：公司的业绩持续提升的原因是什么？</b></p>

**A2:** 公司的业绩持续提升的主要原因是：一是公司坚持创新驱动，加强前瞻性技术布局，并加速技术优势到产品的转化，优化产品结构，实现国产替代是公司业绩增长的主要因素。二是公司积极开拓海外市场，坚持差异化和高端化定位，实现了设备在欧洲、东南亚、北美的落地。凭借卓越的设备性能、先进的技术水平、精湛的工艺设计、强大的交期掌控能力和完善的售后服务体系获得了海外大客户的广泛认可。三是公司的产品向多元化发展，半导体设备和新能源设备业务成长性初显，打开了新的增长空间。四是公司持续优化管理流程，提升研、产、供、销的联动效率，不断强化内部协同，提升运营效率。坚持推行降本增效举措，推行精细化成本核算与管理，通过开源和节流相结合，提升人均创利水平。五是优秀的人才战略与企业文化驱动公司高质量和可持续发展。

**Q3: 公司在半导体领域有何进展？**

**A3:** 公司在半导体领域主要生产半导体后段工序的封装测试设备。主要产品是 COF 倒装机、半导体倒装机、软焊料固晶机、共晶固晶机、AOI 检测机、引线框架贴膜机等高速高精的半导体装备。在先进封装领域公司有针对显示驱动芯片键合设备，COF 倒装设备，该倒装设备是一种采用共晶+倒装的芯片键合工艺的高精度高速度先进封装设备。公司将密切关注行业发展动态和前沿技术的发展趋势，积极创造并把握半导体设备领域的发展机遇。

**Q4: 公司在 VR/AR/MR 显示领域有何布局？**

**A4:** 公司通过不断推陈出新打破技术壁垒，持续自主研发创新，研发的设备已经赢得了 VR/AR/MR 等新型显示领域客户的青睐。在 VR/AR/MR 显示设备领域，公司提供其显示器件生产工艺中所需的设备，相关产品已与合肥视涯等客户建立了合作关系。

**Q5: 公司在 Mini/Micro LED 显示领域的进展如何？**

**A5:** 公司目前在 Mini/Micro LED 显示领域，已经推出芯片分选设备、芯片扩晶设备、检测设备、真空贴膜设备、芯片巨量转移设备、高精度拼接设备等。

**Q6: 公司研发技术人员有多少，研发费用占比多少？**

	<p><b>A6:</b> 公司是一家注重技术研发与创新的国家级高新技术企业和国家级专精特新“小巨人”企业，致力于依靠自主创新实现企业可持续发展。为提升产品竞争力，公司不断加大研发投入，加强自主创新及新产品研发。截至 2024 年 6 月 30 日，公司研发支出 5,930.94 万元，占营业收入 8.82%。为保持公司研发创新优势，公司持续增加研发技术人才的储备，公司拥有研发及技术人员 939 人，占公司总体员工数量的 59.09%。在公司持续加大研发投入、引进优秀技术人才的推动下，公司产品制造水平、研发创新能力一直居于国内同行业的前列。</p> <p><b>Q7: 公司未来有何规划?</b></p> <p><b>A7:</b> 公司将持续加强在半导体显示模组设备、汽车智能座舱系统装备、半导体封测设备及新能源装备领域的研发。积极开拓柔性显示模组设备及显示前端工序贴合类设备、Mini/Micro LED 设备、VR/AR/MR 精密组装设备、汽车智能座舱系统装备、半导体封测设备以及新能源装备在新兴领域的应用市场，同时继续加大这些领域的新技术、新产品研发力度，支撑该业务快速成长。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024-9-6